

# LTK4871 4.2W 高耐压、无干扰式AB类、音频放大器

## ■ 概述

LTK4871 是一款高耐压 4.2W、单声道 AB 类音频功率放大器，工作电压 2.5V-6V，以 BTL 桥连接的方式，在 6V 电源电压下，可以给 4Ω 负载提供 THD 小于 10%、平均为 4.2W 的输出功率。在关闭模式下，电流典型值小于 1uA

LTK4871 是为提供大功率、高保真音频输出而专门设计的，它仅仅需要少量的外围元器件，并且能工作在宽电压条件下（2.5-6V）。LTK4871 不需要耦合电容，自举电容或者缓冲网络，所以非常适用于小音量的低功耗的系统。

## ■ 应用

- 蓝牙音箱、智能音箱
- 便携游戏机，儿童玩具
- 拉杆音箱、扩音器、MP3、
- 各类音频产品

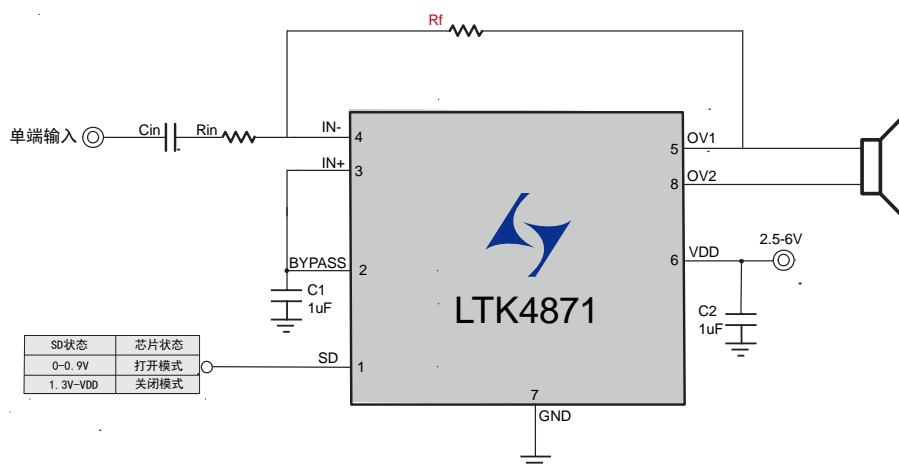
## ■ 特性

- 输入电压范围 2.5V-6V
- 极少的外围元件
- 无需耦合电容，自举电容以及缓冲网络
- 优异的爆破声抑制电路
- 超低底噪、超低失真
- 10% THD+N, VDD=5V, 4Ω 负载下提供高达 3W 的输出功率
- 10% THD+N, VDD=6V, 4Ω 负载下 提供高达 4.2W 的输出功率
- ESOP-8 封装，快速散热
- 短路保护
- 关断电流 < 1uA

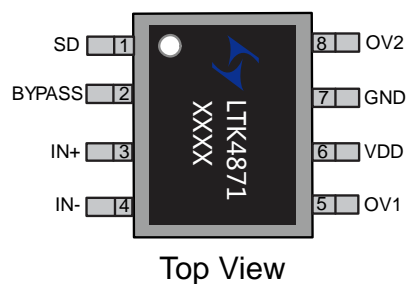
## ■ 封装

芯片型号	封装类型	封装尺寸
LTK4871	ESOP-8	

## ■ 典型应用图



## 管脚说明及定义



管脚编号	管脚名称	I/O	功能说明
1	SD	I	关断控制。高关断，低打开
2	BYPASS	-	内部共模参考电压
3	IN+	I	模拟正向输入端
4	IN-	I	模拟反向输入端
5	VO1	O	BTL 正向输出端
6	VDD	P	电源正端
7	GND	GND	电源负端
8	VO2	O	BTL 反向输出端

## 最大极限值

参数名称	符号	数值	单位
供电电压	$V_{DD}$	6.5V	V
存储温度	$T_{STG}$	-60°C~150°C	°C
结温度	$T_J$	160°C	°C

## 推荐工作范围

参数名称	符号	数值	单位
供电电压	$V_{DD}$	3V~6.2V	V
存储温度	$T_{STG}$	-50°C~150°C	°C
结温度	$T_J$	50°C~160°C	°C

## ESD 信息

参数名称	符号	数值	单位
人体静电	HBM	±2000	V
机器模型静电	CDM	±300	°C

## 基本电气特性

$V_{DD}=5V$ ,  $T_A=25^\circ\text{C}$  的条件下:

信号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD	电源电压		2.5	5	6	V
IDD	静态电源电流	$V_{DD}=2.5V\sim 6V$ , $I_O=0A$	2	2	6	mA
$V_n$	静态底噪	$V_{DD}=5V$ , $AV=20DB$ , $A_{wting}$		56		uV
ISHDN	关断电流	$V_{DD}=2.5V\sim 6V$		0.5		uA
	输出功率	$V_{DD}=6V$ , THD+N=10%, $f=1kHz$ , $R_L=4\Omega$ ;		4.2		

Po		VDD=5V THD+N=10%, f=1kHz, RL=4Ω;	3	W
		VDD=4.2V THD+N=10%, f=1kHz, RL=4Ω;	2.1	
		VDD=6V THD+N=1%, f=1kHz, RL=4Ω;	3.3	
		VDD=5V THD+N=1%, f=1kHz, RL=4Ω;	2.2	
		VDD=4.2V THD+N=1%, f=1kHz, RL=4Ω;	1.6	
		VDD=5V THD+N=10%, f=1kHz, RL=3Ω;	4.2	
		VDD=5V THD+N=10%, f=1kHz, RL=8Ω;	1.7	
		VDD=4.2V THD+N=1%, f=1kHz, RL=8Ω;	1.2	
		THD+N	总谐波失真加噪声	
OTP	过温保护		165	°C
PSRR	电源电压抑制比	VDD=5V, VRIPPLE=200mVRMS, RL=8Ω, CB=2.2μF	80	dB
SDopen	SD脚开启电压	VDD=6V	<1.7	V
		VDD=5V	<1.5	
		VDD=4V	<1.3	
		VDD=3V	<1.1	
SDsd	SD脚关闭电压	VDD=6V	>1.9	
		VDD=5V	>1.7	
		VDD=4V	>1.5	
		VDD=3V	>1.3	
VDDopen	VDD开启电压	SD=0	>2.5	V
VDDsd	VDD关闭电压	SD=0	<0.8	V
Topen	开启时间	VDD =5V, BYPASS=1uf,	260	Ms

## 性能特性曲线

$A_V=20\text{dB}$ ,  $\text{BYPASS}=1\mu\text{f}$   $T_A=25^\circ\text{C}$ , 无特殊说明项均是在VDD=5V, 4Ω条件下测试:

描述	测试条件	编号
Input Amplitude VS. Output Amplitude	VDD=5V, RL=4Ω	1
Input Voltage VS. Maximum Output Power	RL=4Ω, THD=10%	2
Output Power VS. THD+N	VDD=5V, RL=4Ω, $A_V=20\text{DB}$	3
	VDD=4.2V, RL=4Ω, $A_V=20\text{DB}$	
Input Voltage VS. Power Crrent	VDD=3.0V-5V, RL=4Ω,	5
Frequency VS. THD+N	VDD=5V, RL=4Ω, $A_V=20\text{DB}$ , $P_O=0.2\text{W}$	6
Frequency Response	VDD=5V, RL=4Ω	7

● 特性曲线

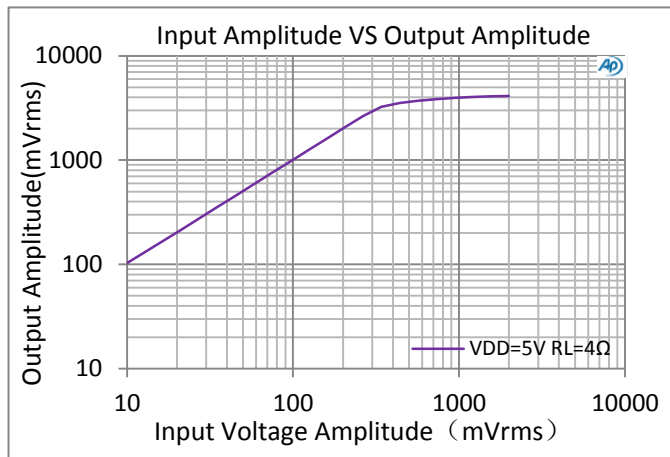


图1: Input Amplitude VS. Output Power

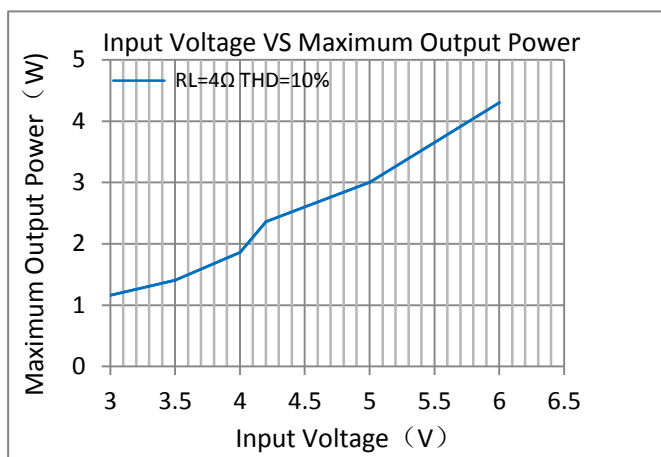


图2: Input Voltage VS. Output Power

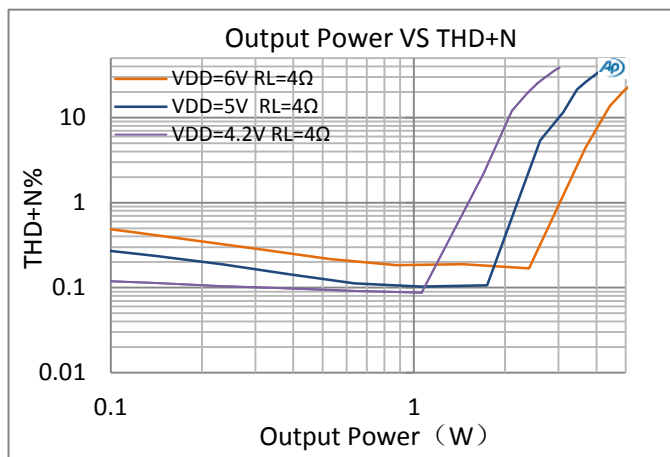


图3: Output Power VS. THD+N

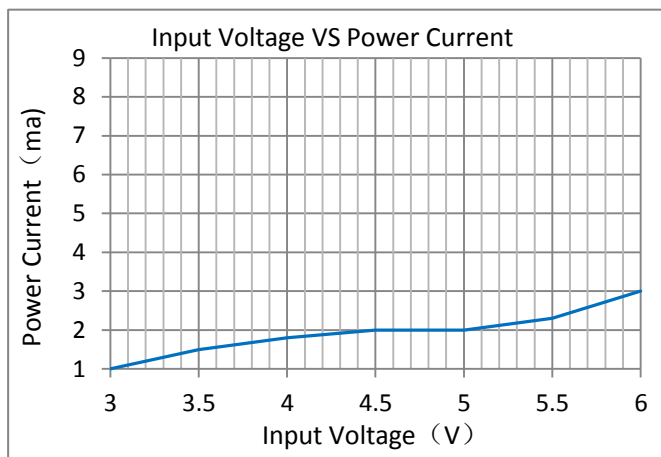


图4: Input Voltage VS. Power Current

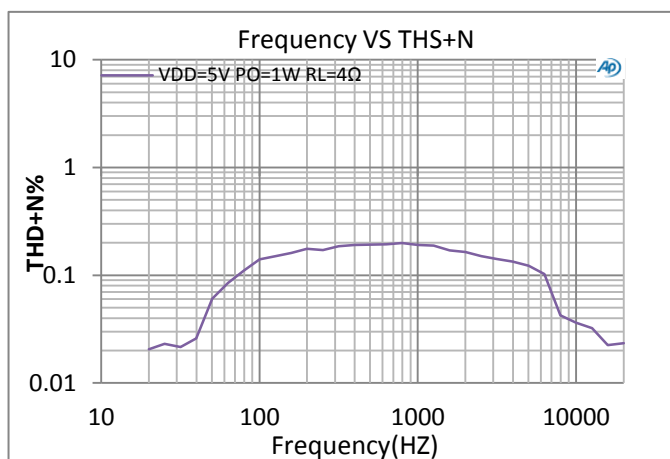


图5: Frequency VS. THD+N

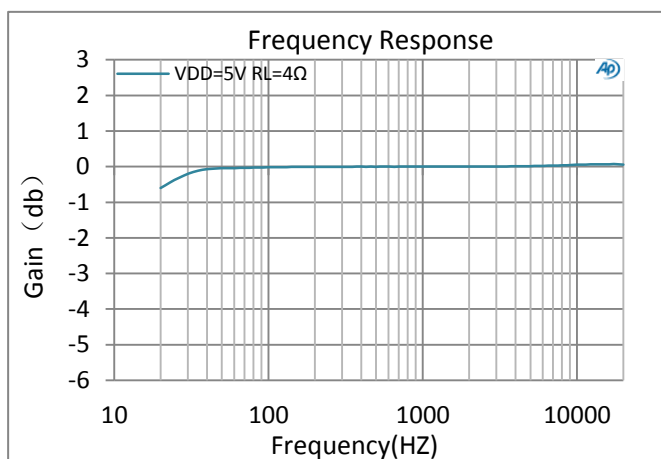


图6: Frequency Response

## ■ 应用说明

### ● SD管脚控制

SD管脚是芯片使能脚位。控制芯片打开和关闭，SD管脚为高电平时，功放芯片关断，SD管脚为低电平时，功放芯片打开，正常工作。SD管脚不能悬空。

SD管脚	芯片状态
低电平	打开状态
高电平	关闭状态

### ● 功放增益控制

LTK4871接受模拟信号输入，输出为模拟音频信号，其增益均可通过 $R_{IN}$ 调节，计算公式为：

$$A_V = 2 \times \left( \frac{R_f}{R_i} \right)$$

$A_V$ 为增益，通常用DB表示，上述计算结果单位为倍数、 $20\text{Log}$ 倍数=DB。

LTK4871的串联电阻（ $R_{in}$ ）和反馈电阻（ $R_f$ ）都由外部定义，用户可根据根据实际供电电压、输入幅度、和失真度定义。

如 $R_f=56K$ 时， $R_i=10K$ 。 $A_V=2*56/10、=11.2$ 倍、 $A_V=20.2\text{DB}$

输入电容（ $C_{in}$ ）和输入电阻（ $R_{in}$ ）组成高通滤波器，其截止频率为：

$$f_c = \frac{1}{2\pi \times R_{IN} \times C_{IN}}$$

$C_{in}$ 电容选取较小值时，可以滤除从输入端耦合入的低频噪声，同时有助于减小开启时的POPO声

### ● Bypass电容

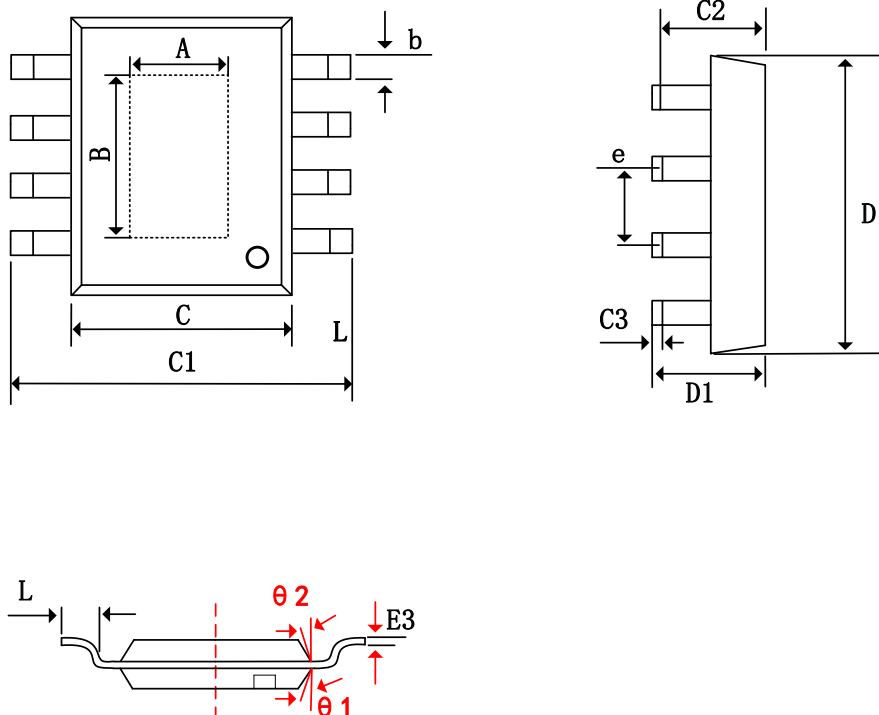
Byp电容是非常重要的，该电容的大小决定了功放芯片的开启时间，同时Byp电容的大小会影响芯片的电源抑制比、噪声、以及POP声等重要性能。建议将该电容设置为 $1\mu\text{f}$ ，因该Byp的充电速度速度比输入信号端的充电速度越慢，POP声越小。

### ● 电源去藕

LTK4871是高性能CMOS音频放大器，足够的电源退耦可保证输出THD和PSRR尽可能小。电源的退耦需要可以用插件电容和陶瓷电容组合来实现。陶瓷电容典型值为 $1.0\mu\text{F}$ ，放置在尽可能靠近器件VDD端口可以得到最好的工作性能，

### ● PCB设计注意事项

- 芯片供电VDD脚位，建议使用一个贴片电容，电容值为 $1\mu\text{f}$ 。为了提升芯片工作性能以及让电源在动态时更稳定，可在VDD处使用一个插件电容 $220\mu\text{f}-470\mu\text{f}$ 。
- 功放芯片电源走线要粗，最好使用敷铜方式连接。电源供电脚（VDD）走线网络中如有过孔必须使用多孔连接，并加大过孔内径，不可使用单个过孔直接连接。
- BYPASSD电容尽量靠近芯片管脚放置。
- 输入电容（ $C_i$ ）、输入电阻（ $R_i$ ）尽量靠近功放芯片管脚放置，音频走线最好使用包地处理，可以有效的抑制其他信号耦合的噪声。
- LTK4871 输出连接到喇叭的管脚走线管脚尽可能的短，并且走线宽度不能过小。

**■ 芯片封装 ESOP-8**


字符	Dimensions In Millimeters			Dimensions In Inches		
	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
A	2.31	2.40	2.51	0.091	0.094	0.098
B	3.20	3.30	3.40	0.126	0.129	0.132
b	0.33	0.42	0.51	0.013	0.017	0.020
C	3.8	3.90	4.00	0.150	0.154	0.157
C1	5.8	6.00	6.2	0.228	0.235	0.244
C2	1.35	1.45	1.55	0.053	0.058	0.061
C3	0.05	0.12	0.15	0.004	0.007	0.010
D	4.70	5.00	5.1	0.185	0.190	0.200
D1	1.35	1.60	1.75	0.053	0.06	0.069
e	1.270 (BSC)			0.050 (BSC)		
L	0.400	0.83	1.27	0.016	0.035	0.050

声明：北京联辉科电子技术有限公司保留在任何时间、不另行通知的情况下对规格书的更改权。

北京联辉科电子技术有限公司提醒：请务必严格应用建议和推荐工作条件使用。如超出推荐工作条件以及不按应用建议使用，本公司不保证产品后续的任何售后问题。